

株式会社 京都銀行

京都市下京区烏丸通松原上る  
郵便番号 600-8652

## 中小・ベンチャー企業のビジネスプラン発表会

## 「京銀・KIIPビジネス・フォーラム」参加企業を募集します！

京都銀行（頭取 高崎 秀夫）では、平成26年12月15日（月）に、優れた技術・製品・ビジネスアイデアを持つ中小・ベンチャー企業と、新製品・新技術開発テーマを探している大手・中小企業とのマッチングを図ることを目的に開催する「京銀・KIIPビジネス・フォーラム」への参加企業を募集しますのでお知らせいたします。

当フォーラムでは、公募により選出された7社によるプレゼンテーションと、参加企業同士の交流を深めていただく情報交換の場を提供いたします。

新技術・新製品の開発や新事業展開等に関心をお持ちの方、新たなビジネスパートナーをお探しの方など、中小・ベンチャー企業との協業に関心をお持ちの方はぜひご参加ください。

当行では、今後も地元企業の成長・発展への支援を通じて、より一層地域活性化に貢献できるよう努めてまいります。

※KIIP … IT 融合ビジネスパートナーズの略称。一般財団法人 関西情報センターが事務局となり運営する、大手企業と中小・ベンチャー企業のパートナー作り支援事業。具体的には、関西大手企業が中小・ベンチャー企業等の技術・ビジネス提案を受け付け、新たな製品やサービスの開発へ繋げていくためのマッチングを図る仕組みとなっている。

記

## 開催内容

セミナー名	京銀・KIIPビジネス・フォーラム
日時	平成26年12月15日（月） 13:30～18:00（受付開始：13:00）
会場	京都銀行 金融大学校 桂川キャンパス（京都市南区久世高田町376番地7）
内容	<b>【 中小・ベンチャー企業からのプレゼンテーション 】</b> （7社） <発表企業 五十音順> ※発表順・タイトルは変更の可能性があります。 ・株式会社 アロマジョイン（京都府相楽郡精華町） 「香り噴射装置を用いたセールスプロモーション」 ・イーセップ 株式会社（京都府相楽郡精華町） 「ナノセラミック分離膜の開発とエネルギー産業への展開」 ・株式会社 エマオス京都（京都市南区） 「新規多孔性高分子材料の可能性」

	<ul style="list-style-type: none"> <li>・株式会社 SOBAプロジェクト（京都市下京区） 「世界で唯一のビジュアルコミュニケーション・プラットフォーム」</li> <li>・株式会社 第一精工舎（大阪府大東市） 「プラスチック成形法の新工法の可能性」</li> <li>・フェイバー・アプリケーションズ 株式会社（大阪府高槻市） 「オウンドメディアとビジネスマッチング事業」</li> <li>・リボンディスプレイジャパン 株式会社（京都市西京区） 「次世代ディスプレイ対応電子デバイスのビジネスモデル構築」</li> </ul> <p><b>【 交流会 】</b> 参加企業間の交流および情報交換を図る場を提供いたします。</p>
主 催	京都銀行、一般財団法人 関西情報センター（KIIP 事務局）
定 員	先着100名
対 象	新規性の高い技術・アイデアを持つ中小・ベンチャー企業との協業に関心をお持ちの企業
参加費用	無 料
申込方法	お取引店にてお申し込みいただくか、当行ホームページに掲載している申込書により「京都銀行 営業支援部」宛て、FAXにてお申し込み下さい。
申込期限	平成26年12月5日（金） ※定員になり次第、期限前でもお申し込みを締め切らせていただきます。

＜本件に関するお問い合わせ先＞

営業支援部 地域密着型金融推進室 TEL：075-361-2293 FAX：075-341-5984

以 上